

**SVP-534** 

# Процессорный модуль форм-фактора VPX 3U на базе Intel Xeon D-15xx





## Основные особенности

- Процессор (система на кристалле) Intel Xeon D-15xx или Intel Pentium D15xx с количеством ядер от 2 до 16 и тактовой частотой до 2,2 ГГц
- Два канала распаиваемой памяти DDR4-2400 с поддержкой ECC, общим объёмом до 32 Гбайт
- Слот М.2 (ключ М) для установки накопителей SSD М.2 2260 с интерфейсом SATA 6 Гбит/с
- Разъёмы XMC J15 и J16 (соответствующие стандартам ANSI/VITA 42.0-2008 (R2014) или ANSI/VITA 61.0-2011 (R2014)) для установки субмодуля XMC/XMC 2.0 или мезонина с накопителем NVMe M.2 2280 (с интерфейсом SATA 6 Гбит/с или PCI Express 3.0 x4)
- Вывод сигналов (X8d + X24s) с разъёма XMC I/O (J16) на разъём VPX P2
- Модуль форм-фактора VPX 3U, соответствующий стандартам: ANSI/VITA 46.0-2013 (воздушное охлаждение), ANSI/VITA 48.2-2010 (кондуктивное охлаждение) и ANSI/VITA 65-2010 (R2012) OpenVPX
- Профиль модуля: MOD3-PAY-2F2U-16.2.3-3, согласно ANSI/VITA 65 OpenVPX
- Два варианта исполнения модуля: воздушное охлаждение (радиатор) или кондуктивное охлаждение (clamshell)
- Поддержка широкого спектра интерфейсов на разъёмах VPX P1 и P2: PCI Express 3.0, PCI Express 2.0, 10GBASE-KR, 1000BASE-KX, SATA 6 Гбит/с, USB 3.0, USB 2.0, VGA, LPC, UART
- Выбор активных интерфейсов «RTM» на разъёме VPX P1 и P2 осуществляется в зависимости от типа подключенного модуля RTM
- Интерфейсы передней панели: Gigabit Ethernet, HDMI, VGA, USB 3.0, USB 2.0
- Выбор между стандартными интерфейсными разъёмами на переднем мезонине и общим единым разъёмом с винтовой фиксацией для применения в жёстких условиях или с кондуктивным охлаждением
- Поддержка наборов инструкций Intel AVX и AVX2 для эффективной обработки данных с плавающей точкой
- Выделенная подсистема IPMI для удаленного управления модулем и контроля за его состоянием
- Поддержка функции горячей замены модуля в системе



# Обзор модуля

#### Особенности

Процессорный модуль SVP-534 разработки ЗАО «Скан Инжиниринг Телеком» основан на высокопроизводительном серверном процессоре Intel Xeon D-15xx, архитектуры Broadwell, с низким энергопотреблением. Он представляет собой однокристальную систему, в которую интегрированы вычислительные ядра, контроллер памяти DDR4, а также интерфейсы ввода/вывода, включая высокоскоростные PCI Express 3.0, 10 Gigabit Ethernet, SATA 6 Гбит/с. Модуль выполнен в форм-факторе VPX 3U и предлагает различные варианты построения высокопроизводительного сервера в рамках систем стандарта VPX 3U, применяемых в обычных или жёстких условиях эксплуатации.

Двухканальный контроллер оперативной памяти работает с распаиваемой памятью DDR4-2400 с поддержкой контроля четности (ECC), что позволяет предотвратить возникновение ошибок при длительной обработке больших объёмов данных.

Наличие резервной микросхемы BIOS позволяет предотвратить потерю работоспособности системы после некорректной настройки BIOS или повреждения содержимого одной из микросхем.

Все компоненты модуля рассчитаны на применение в сложных климатических условиях. Использование твердотельных накопителей (SSD) существенно повышает надежность системы при работе в условиях повышенных механических нагрузок.

Выделенная подсистема контроля и управления IPMI взаимодействует с блоком мониторинга температур и напряжений питания, что позволяет контролировать состояние модуля не только локально, но и удаленно, снижая риск возникновения сбоя системы или выхода оборудования из строя.

#### Возможности расширения

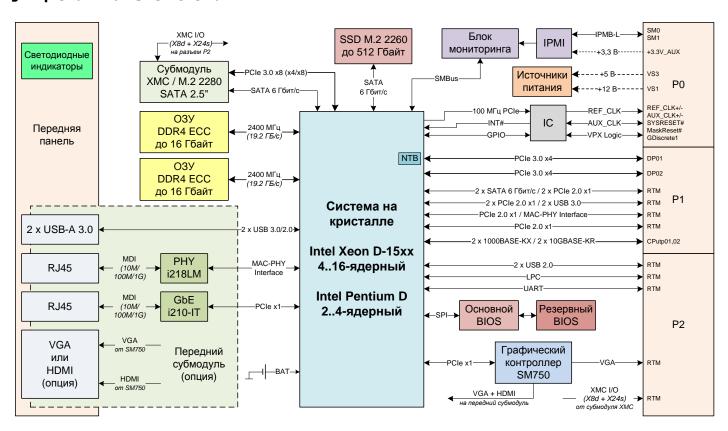
Расширение функциональных возможностей модуля SVP-534 возможно за счет сменных передних интерфейсных мезонинов, дополнительных субмодулей XMC (устанавливаемых в кондуктивном варианте исполнения модуля), а также за счет интерфейсов, выведенных на разъёмы VPX P1 и P2, подключаемых к объединительной плате VPX и транслируемых на сменные модули RTM, которые могут устанавливаться в крейтах VPX. Все перечисленное позволяет адаптировать модуль под конкретные аппаратные конфигурации систем VPX и различные условия эксплуатации этих систем.

Модуль SVP-534 оснащен разъёмом М.2 (ключ М) для установки накопителей SSD М.2 2260 с интерфейсом SATA 6 Гбит/с, а также может быть оснащен дополнительным мезонином с накопителем SSD/NVMe М.2 2280 (с интерфейсом SATA 6 Гбит/с или PCI Express 3.0 х4), устанавливаемым в разъём XMC J15. Все это позволяет модернизировать или расширять дисковую подсистему модуля с минимальными затратами.

#### Совместимость с операционными системами (ОС)

Контроллеры интерфейсов и интегрированные устройства процессора не требуют написания специального программного обеспечения, все поставляемые драйверы совместимы с большинством ОС. Стандартная поставка модуля обеспечивает драйверную поддержку в следующих ОС: Microsoft Windows 7/8.1/10, Embedded Standard 7/8.1, Server 2008 R2 SP1/2012/2012 R2, QNX Neutrino RTOS 6.5.0/6.6.0, 3OCPB «Нейтрино» (КПДА.10964-01), Astra Linux Special Edition 1.5, защищённая ОС «Заря», МСВС 3.0 ФЛИР.80001-16 изм. №3 и Linux (с версией ядра 4.2.0 и выше).

# Функциональная блок-схема





# Технические характеристики

#### Процессор

Система на кристалле Intel Xeon D-15xx, архитектура Broadwell, 14 нм:

- тактовая частота в зависимости от количества ядер и режима Turbo Boost:
  - 4 ядра 2,2 ГГц (до 2,7 ГГц);
  - 6 ядер 1,9 ГГц (до 2,5 ГГц);8 ядер 2 ГГц (до 2,6 ГГц);

  - 12 ядер 1,5 ГГц (до 2,1 ГГц);
  - 16 ядер 1,3 ГГц (до 2,1 ГГц).
- кэш:
  - 32/32 кбайт (инструкции/данные), на каждое ядро;
  - 256 кбайт MLC на каждое ядро;
  - 1,5 Мбайт LLC на каждое ядро (6/9/12/18/24 Мбайт на кристалл).
- возможность обработки до 8/12/16/24/32 потоков данных одновременно;
- встроенный контроллер памяти DDR4;
- встроенные контроллеры интерфейсов: 10 Gigabit Ethernet и SATA 6 Гбит/с;
- контроллер шины PCI Express 3.0;
- поддержка технологий и наборов инструкций:
  - Intel SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2;
  - Intel HT:
  - Intel AVX, AVX2;
  - Intel SpeedStep;
  - Intel Turbo Boost 2.0;
  - Intel TSX-NI:
  - Intel VT-d, VT-x;
  - Intel EM64T; - Intel XD-Bit:
  - Intel TXT.
- периферийные интерфейсы:
  - 1 × PCle 3.0 x8 / 2 × PCle 3.0 x4;
  - 2 × PCle 3.0 x4;
  - 6 × PCle 2.0 x1;
  - 4 × SATA 6 Гбит/с;
  - 2 × 1000BASE-KX / 2 × 10GBASE-KR;
  - 4 × USB 3.0;
  - 4 × USB 2.0;
  - 1 × UART; 1 × LPC;
  - 1 × SPI.

Возможна установка 2- или 4-ядерного процессора Intel Pentium D15xx с частотой ядер 2,2 ГГц или 1,6 ГГц соответственно.

## Память

Распаиваемая память DDR4-2400 с поддержкой ЕСС, общим объёмом до 32 Гбайт

Накопитель SSD M.2 2260, объемом до 512 Гбайт, интерфейс SATA 6 Гбит/с

Дополнительный мезонин с накопителем SSD/NVMe M.2 2280 объёмом до 1 Тбайта, с интерфейсом SATA 6 Гбит/с или PCI Express 3.0 x4

BIOS Flash: 2 × 16 Мбайт с функцией резервирования

#### Разъёмы VPX

#### Разъём Р0:

- системные сигналы;
- сигналы тактирования REF\_CLK+/- и AUX\_CLK+/-.

## Разъём Р1:

- 2 × PCle 3.0 х4 (порты DP01, DP02);
- 2 × 1000BASE-KX / 2 × 10GBASE-KR (порты CPutp01, CPutp02);
- 2 × SATA 6 Гбит/с / 2 × PCIe 2.0 x1;
- 2 × PCle 2.0 x1 / 2 × USB 3.0;
- 1 × PCle 2.0 x1;
- 1 × PCIe 2.0 x1 или интерфейс МАС-РНҮ для i218-LM.

#### Разъём Р2:

- XMC I/O (X8d + X24s);
- 2 × USB 2.0;
- 1 × LPC:
- 1 × UART;
- 1 × VGA.

Выбор активных интерфейсов на разъёме VPX P1 зависит от типа подключенного модуля RTM

#### Соответствие стандартам

ANSI/VITA 46.0-2013 VPX Base Standard

ANSI/VITA 48.2-2010 Mechanical Specifications for Microcomputers Using REDI Conduction Cooling Applied to VITA VPX

ANSI/VITA 65-2010 (R2012) OpenVPX System Standard

Профиль модуля: MOD3-PAY-2F2U-16.2.3-3

IPMI v. 1.5 с поддержкой служебных функций

## Интерфейсные контроллеры

Графический контроллер: вывод графической информации на разъём HDMI или VGA передней панели и разъём VPX P2

Контроллер 10 Gigabit Ethernet:  $2 \times 1000$ BASE-KX или  $2 \times 10$ GBASE-KR Ethernet на разъём VPX P1 (интерфейсы CPutp01,02)

Контроллер Ethernet: 1 × Gigabit Ethernet (MDI) на разъём RJ45 передней панели

Контроллер Ethernet Intel i218LM: 1 × Gigabit Ethernet (MDI) на разъём RJ45 передней панели

## Поддержка ОС

Microsoft Windows 7/8.1/10, Embedded Standard 7/8.1, Server 2008 R2 SP1/2012/2012 R2

ONX Neutrino RTOS 6.5.0/6.6.0

3ОСРВ «Нейтрино» (КПДА.10964-01)

Astra Linux Special Edition 1.5

Защищённая ОС «Заря»

МСВС 3.0 ФЛИР.80001-16 изм. №3

Linux (с версией ядра 4.2.0 и выше) (Поддержка других ОС уточняется отдельно)

#### Разъёмы на передней панели

- 1 × VGA: графический интерфейс VGA или
- 1 × HDMI: интерфейс HDMI/DVI
- 2 × RJ45: Gigabit Ethernet (MDI)
- 2 × USB: USB 3.0/2.0

#### Система мониторинга и управления ІРМІ

Автоматическое отключение питания при возникновении серьёзных сбоев на модуле

Мониторинг температур и напряжений питания модуля

Ведение журнала учета отказов блоков системы

Возможность удаленного контроля и управления модулем

Информационная шина на разъёме VPX P0 для управления и мониторинга (SM[1:0])

Поддержка «горячей замены» (Hot Swap)

## Тактирование и синхронизация

Модуль может выступать источником тактового сигнала REF\_CLK+/-

Модуль может генерировать/принимать тактовый сигнал AUX\_CLK+/- для задач синхронизации

## Энергопотребление

Потребляемая мощность процессорного модуля: от 35 до 60 Вт (без учета субмодуля ХМС)

Распределение потребляемой мощности по линиям питания:

- +12 B (VS1): до 5 A (60 Вт);
- +3,3 B (3.3V AUX): до 0,08 A (0,3 Вт).

#### Режим электропитания:

- питание модуля осуществляется от линии +12 В;
- питание субмодуля ХМС осуществляется от линии +5 В или от линии +12 В, по выбору пользователя.

#### Условия эксплуатации

Охлаждение: воздушное или кондуктивное

Диапазон рабочих температур: коммерческий (0...+50 °C) или индустриальный (-40...+85 °C)

Температура хранения: -40...+85 °C

Влажность: 95 % без конденсата

Возможность нанесения влагозащитного покрытия для жёстких условий

#### Размеры

Форм-фактор: VPX 3U

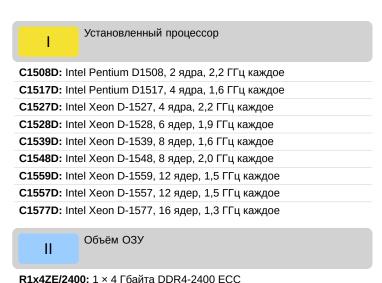
Ширина передней панели: 5НР

Размеры: 160 × 100 × 25,06 мм



# Информация для заказа





R2x8ZE/2400: 2 × 8 Гбайт DDR4-2400 ECC R2x16ZE/2400: 2 × 16 Гбайт DDR4-2400 ECC Ёмкость накопителя М.2 Ш **DMT0:** Не установлен **DMT1x60/2260:** 1 × 60 Гбайт SSD M.2 2260

**DMT1x120/2260:** 1 × 120 Гбайт SSD M.2 2260 **DMT1x240/2260:** 1 × 240 Гбайт SSD M.2 2260 **DMT1x480/2260:** 1 × 480 Гбайт SSD M.2 2260

R2x4ZE/2400: 2 × 4 Гбайта DDR4-2400 ECC

Передний мезонин

М1х0: Мезонин(ы) отсутствует(ют) M1x18: С обычными разъёмами M1x19: С единым разъёмом Molex

Задний мезонин

М2х0: Мезонин(ы) отсутствует(ют)

M2x20: Для накопителя SSD/NVMe M.2 2280

Исполнение (температурный диапазон)

**Т0:** Коммерческое (0...+50 °C) **Т1:** Индустриальное (-40...+85 °C)

Покрытие VII

СV0: Без влагозащитного покрытия **CV1:** С влагозащитным покрытием

Охлаждение VIII

**CL0**: Воздушное **CL1**: Кондуктивное

Пример кода изделия: SVP-534-C1577D-R2x16ZE/2400-DMT1x480/2260-M1x19-M2x20-T1-CV1-CL1

SVP-534 — Процессорный модуль форм-фактора VPX 3U на базе Intel Xeon D-15xx

Установленный процессор: Intel Xeon D-1577, 16 ядер, 1,3 ГГц каждое

**Объём ОЗУ:** 2 × 16 Гбайт DDR4-2400 ECC

Ёмкость накопителя **M.2**: 1 × 480 Гбайт SSD M.2 2260 Передний мезонин: С единым разъёмом Molex Задний мезонин: Для накопителя SSD/NVMe M.2 2280

Исполнение (температурный диапазон): Индустриальное (-40...+85 °C)

Покрытие: С влагозащитным покрытием

Охлаждение: Кондуктивное

Возможны другие конфигурации модуля по индивидуальному запросу. За дополнительной информацией обращайтесь в SET.

# Контактная информация



ЗАО «Скан Инжиниринг Телеком» Россия, 394030, г. Воронеж, ул. Свободы, 75

Электронная почта: Отдел продаж: sales@setdsp.ru

Тел.: +7 (473) 272-71-01, факс.: +7 (473) 251-21-99 www.setdsp.ru

Электронная почта:

www.setdsp.ru

Отдел продаж: sales.spb@setdsp.ru

ООО «Скан Инжиниринг Телеком - СПб»

Тел.: +7 (812) 406-99-95, +7 (812) 406-99-96

Россия, 199106, г. Санкт-Петербург, 22-я линия В.О., д. 3, корп. 1, лит. М.

ЗАО «Скан Инжиниринг Телеком». Все права защищены. © 1991–2018 Документ DS-SVP-534 1.0 создан в ООО «Скан Инжиниринг Телеком - СПб». Все права защищены. © 2018